

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3310d			
形名		/2603s	/2620s	/2630s	/2630Ls
形番		TN8100-2241T	TN8100-2242T	TN8100-2243T	TN8100-2244T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2630Lv3
	動作周波数	1.60GHz	2.40GHz	2.40GHz	1.80GHz
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/2			
	インテル® スマート・キャッシュ(ラスト・レベル・キャッシュ)	15MB		20MB	
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	6C/6T	6C/12T	8C/16T	
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 (4GB/s)			
	インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応			
	インテル® ハイパー・スレッディング・テクノロジー	—	対応		
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	—	対応		
チップセット		インテル® C612 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 256GB (16x 16GB), Load Reduced DIMM : 512GB (16x 32GB)			
	搭載メモリ	DDR4-2133 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR4-2133 Load Reduced DIMM (32GB)			
	最大動作周波数	1600MHz	1866MHz		
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)			
	メモリスベアリング	対応			
	メモリミラーリング	対応			
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	—		
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 8TB (8x 1TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), 2.5 型 SSD: SATA 6.4TB (8x 800GB), SAS 3.2TB (8x 400GB)		
		ホットプラグ	対応		
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1			
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
	拡張ベイ	—			
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト, 220mm サイズ) (オプション) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル, 220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザーカード手配で、PCI Express 3.0(x16 レーン, x16 ソケット)に変更が可能)			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB			
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200			
標準インターフェース		4x USB3.0 *3 (2x 前面(TypeA), 2x 背面(TypeA)), 1x USB2.0 (1x 内部(Box 10pin)), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面), 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (4x 1000BASE-T, 2x 10GBASE-T もしくは 2x 1000BASE-T + 2x 10GBASE-SFP+ の LOM カードを選択必須)			
キーボード・マウス		オプション			
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ不可)			
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) *4		439.8mm x 722.0mm x 43.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)			
		482.4mm x 816.0mm x 44.1mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)			

質量 (最小 *5 / 最大)	14.6kg / 21.0kg (レール含む)			
電源	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) 電源ユニット(TN8181-121T,122T) 460W/800W 80 PLUS Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
消費電力(100V 最大構成時, 25°C高負荷時)	283VA/281W	389VA/386W	398VA/395W	323VA/320W
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)	462VA/459W	560VA/556W	574VA/570W	506VA/502W
消費電力(200V 最大構成時, 25°C高負荷時)	280VA/278W	385VA/382W	394VA/391W	319VA/317W
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)	457VA/454W	555VA/551W	568VA/564W	500VA/497W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS) *6	0.270(J 区分)	対象外 *7	対象外 *7	対象外 *7
音量	音圧レベル(100V 最大構成時、高負荷時)	53.0dB	53.0dB	53.0dB
温度/湿度条件	動作時: 10~40°C, 保管時: -10~55°C / 動作時: 20~80%, 保管時: 20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgentService(Windows 版), ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール			
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (RTM, SP2 以降) *8, Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (RTM, SP2 以降) *8, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter,		
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86), Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86_64)		
	VMware	VMware® ESXi™ 5.1 Update 2, VMware® ESXi™ 5.5 Update 2 *9		

*1: 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI を全システムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付 DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: Windows Server® 2008, VMware® ESXi™ 5.1, VMware® ESXi™ 5.5 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: 防塵ベゼル実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「フロントベゼル」の項を参照してください。

*5: 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, LOM カード)

*6: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合論理性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

*7: 省エネルギー法(2011 年度目標基準)の規制対象外です。

*8: 32 ビット版のみサポート対象です。

*9: VMware® ESXi™ 5.5 のインストールには 5GB 以上の論理メモリ容量が必要です。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー効率計画基準への適合 (Y/N)	適合予定			
低電力モード消費電力(W)	52	52	54	49
グリーン購入法特記事項(2015 年 2 月閣議決定)	適合			
省エネ法関連特記事項	省エネ法基準適合	省エネ法規制対象外 *1		
リサイクル設計 (Y/N)	Y			
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N		
	使用箇所	-		
リサイクル関連特記事項	25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示			
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付無し)			
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDEs)の不使用 (Y/N)	Y			
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	N			
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N			
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)	Y			

*1 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011 年度目標基準)規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3310d			
形名		/2640s	/2650s	/2650Ls	/2660s
形番		TN8100-2245T	TN8100-2246T	TN8100-2247T	TN8100-2248T
CPU	搭載 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2640v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650Lv3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660v3
	動作周波数	2.60GHz	2.30GHz	1.80GHz	2.60GHz
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/2			
	インテル® スマート・キャッシュ(ラスト・レベル・キャッシュ)	20MB	25MB	30MB	25MB
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	8C/16T	10C/20T	12C/24T	10C/20T
	コントローラー・ハブとの接続	DMI2 (4GB/s)			
	インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応			
	インテル® ハイパー・スレッディング・テクノロジー	対応			
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応				
チップセット		インテル® C612 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 256GB (16x 16GB), Load Reduced DIMM : 512GB (16x 32GB)			
	搭載メモリ	DDR4-2133 Registered DIMM (4/8/16GB), DDR4-2133 Load Reduced DIMM (32GB)			
	最大動作周波数	1866MHz	2133MHz		
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC)			
	メモリスベアリング	対応			
メモリミラーリング	対応				
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-		
		内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 8TB (8x 1TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), 2.5 型 SSD: SATA 6.4TB (8x 800GB), SAS 3.2TB (8x 400GB)		
		ホットプラグ	対応		
	インターフェース規格と RAID 構成	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)			
	光ディスクドライブ	内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1			
	FDD	オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
拡張ベイ	-				
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、220mm サイズ) (オプション) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (ロープロファイル、220mm サイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザーカード手配で、PCI Express 3.0(x16 レーン, x16 ソケット)に変更が可能)			
		1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (フルハイト、220mm サイズ) (オプション)			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオ RAM	マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB			
	グラフィック表示と解像度	1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200			
標準インターフェース		4x USB3.0 *3 (2x 前面(TypeA), 2x 背面(TypeA)), 1x USB2.0 (1x 内部(Box 10pin)), 2x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 前面, 1x 背面), 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面) (4x 1000BASE-T, 2x 10GBASE-T もしくは 2x 1000BASE-T + 2x 10GBASE-SFP+ の LOM カードを選択必須)			
キーボード・マウス		オプション			
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長ファン		対応 (標準, ホットプラグ不可)			
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) *4		439.8mm x 722.0mm x 43.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず)			
		482.4mm x 816.0mm x 44.1mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む)			

質量 (最小*5 / 最大)	14.6kg / 21.0kg (レール含む)			
電源	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) 電源ユニット(TN8181-121T,122T) 460W/800W 80 PLUS Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) 電源ユニット(TN8181-118T) 800W 80 PLUS Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可)(最大 : 2) AC200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)			
消費電力(100V 最大構成時, 25°C高負荷時)	417VA/415W	466VA/463W	366VA/364W	484VA/481W
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)	608VA/604W	656VA/651W	546VA/542W	664VA/660W
消費電力(200V 最大構成時, 25°C高負荷時)	413VA/410W	461VA/458W	362VA/360W	479VA/476W
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)	602VA/598W	649VA/645W	540VA/537W	658VA/653W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率(W/GTOPS) *6	対象外 *7	対象外 *7	対象外 *7	対象外 *7
音量	音圧レベル(100V 最大構成時, 高負荷時)	53.8dB	54.0dB	55.3dB
温度/湿度条件	動作時: 10~40°C, 保管時: -10~55°C / 動作時: 20~80%, 保管時: 20~80% (動作時/保管時ともに結露しないこと)			
主な添付品	EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows 版), ESMPRO/ServerAgentService(Windows 版), ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチトラックレール			
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (RTM, SP2 以降) *8*9, Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (RTM, SP2 以降) *8*9, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise, Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter,		
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86) *9, Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 以降(x86_64)		
	VMware	VMware® ESXi™ 5.1 Update 2, VMware® ESXi™ 5.5 Update 2 *10		

*1: 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI を全システムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付 DVD-ROM をシステムで最低 1 式は必ず手配してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: Windows Server® 2008, VMware® ESXi™ 5.1, VMware® ESXi™ 5.5 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

*4: 防塵ベゼル実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「フロントベゼル」の項を参照してください。

*5: 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット, LOM カード)

*6: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合論理性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

*7: 省エネルギー法(2011 年度目標基準)の規制対象外です。

*8: 32 ビット版のみサポート対象です。

*9: E5-2650v3, E5-2650Lv3, E5-2660v3 搭載モデルは対象外です。

*10: VMware® ESXi™ 5.5 のインストールには 5GB 以上の論理メモリ容量が必要です。

製品環境諸元一覧

国際エネルギー省計画基準への適合 (Y/N)	適合予定			
低電力モード消費電力(W)	54	52	58	55
グリーン購入法特記事項(2015 年 2 月閣議決定)	適合			
省エネ法関連特記事項	省エネ法規制対象外 *1			
リサイクル設計 (Y/N)	Y			
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N		
	使用箇所	-		
リサイクル関連特記事項	25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示			
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)	- (紙媒体の添付無し)			
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDEs)の不使用 (Y/N)	Y			
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)	N			
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)	N			
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)	Y			

*1 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011 年度目標基準)規制対象外です。